

2024年3月期第2四半期 決算説明会

2023年11月10日

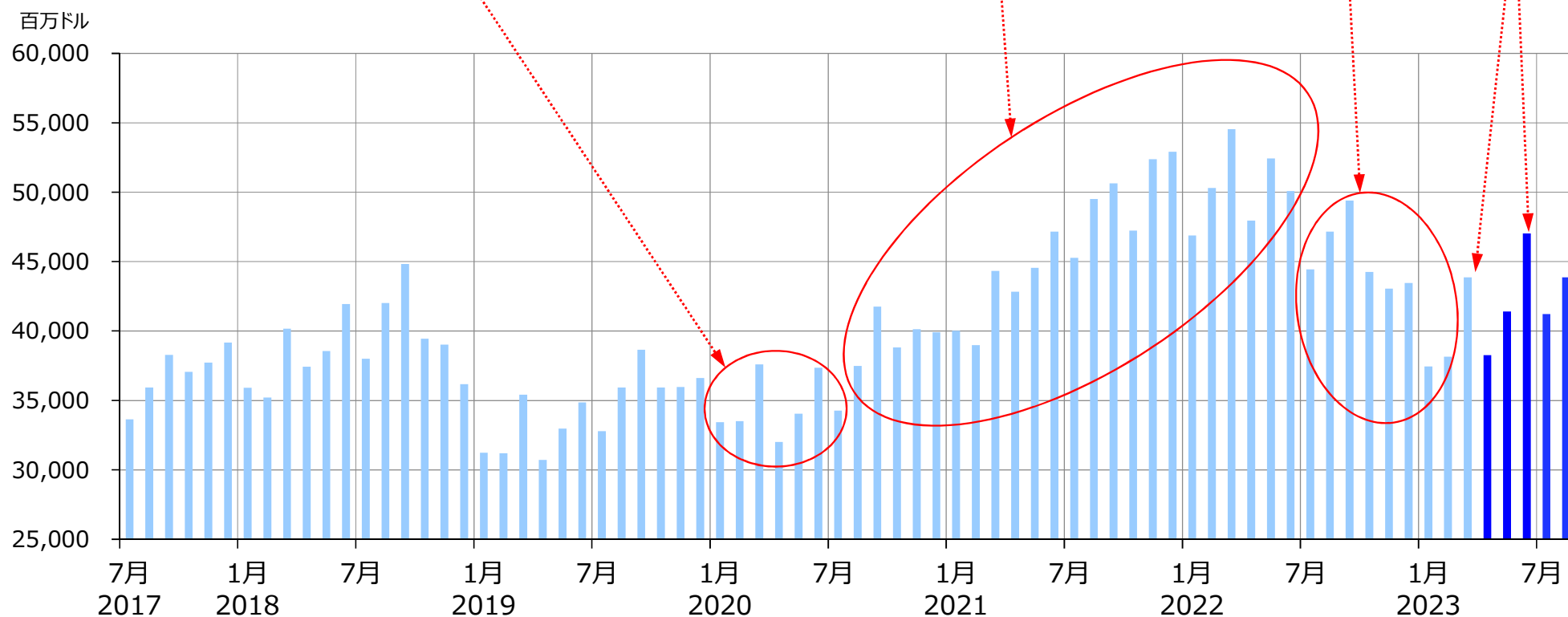
株式会社フジミインコーポレーテッド

市場概況

世界半導体市場動向（月次 実績 ※2023年8月まで）

出所：WSTS（2023/10）

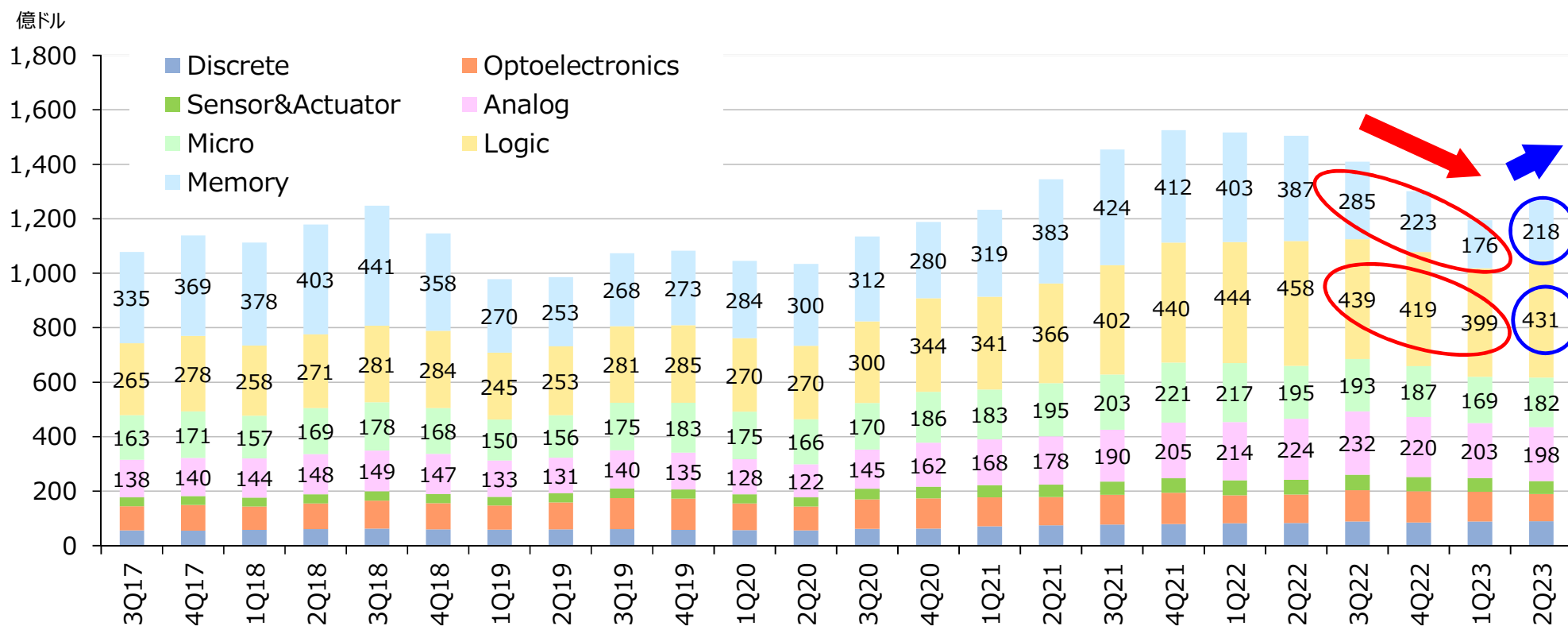
- 2020年、新型コロナの影響で1月より下降 同年8月以降上昇に転じ、強い半導体需要が2022年6月まで継続
- 2022年、生産及び在庫の調整が見られ7月以降減速、2023年1月には2年半前（20年8月）の水準を割り込むまで下落、3月6月の上昇は周期的なものと思料も、金額ベースでは回復傾向にある



世界半導体市場動向（四半期 実績） 用途別

出所：WSTS

- 22年3Q（7-9月期）から23年1Q（1-3月期）まで半導体市場は縮小が続いた
- 23年2Q（4-6月期）は、高価値の生成AI向け半導体の影響でQoQ拡大
 □ジック(QoQ +8%, YoY -6%) メモリ(QoQ +24%, YoY -44%)

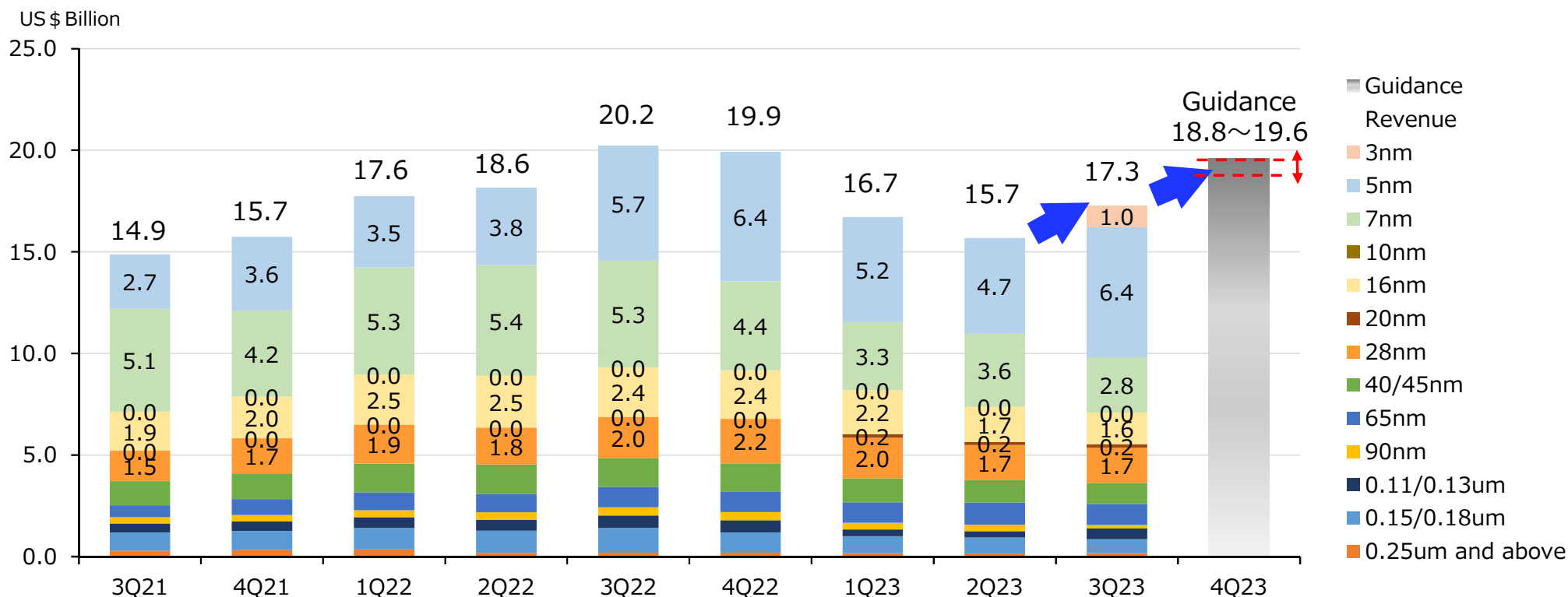


《暦年ベース》

台湾セミコンダクター（TSMC）売上高（2023年7-9月期）

出所：TSMC公開情報よりフジミ作成

- 23年3Q（7-9月期） 売上高 QoQ +10%, YoY -15%
7nm, 16nmの売上高は減少するも、最先端半導体 3nm立上げ、5nmの売上高が増加
- 23年4Q（10-12月期） ガイダンスでは、売上高 QoQ +9%~13%
- 23年の設備投資計画 320-360億米ドル に対し、Q3累計設備投資額 252億米ドル （22年通期 363億米ドル）

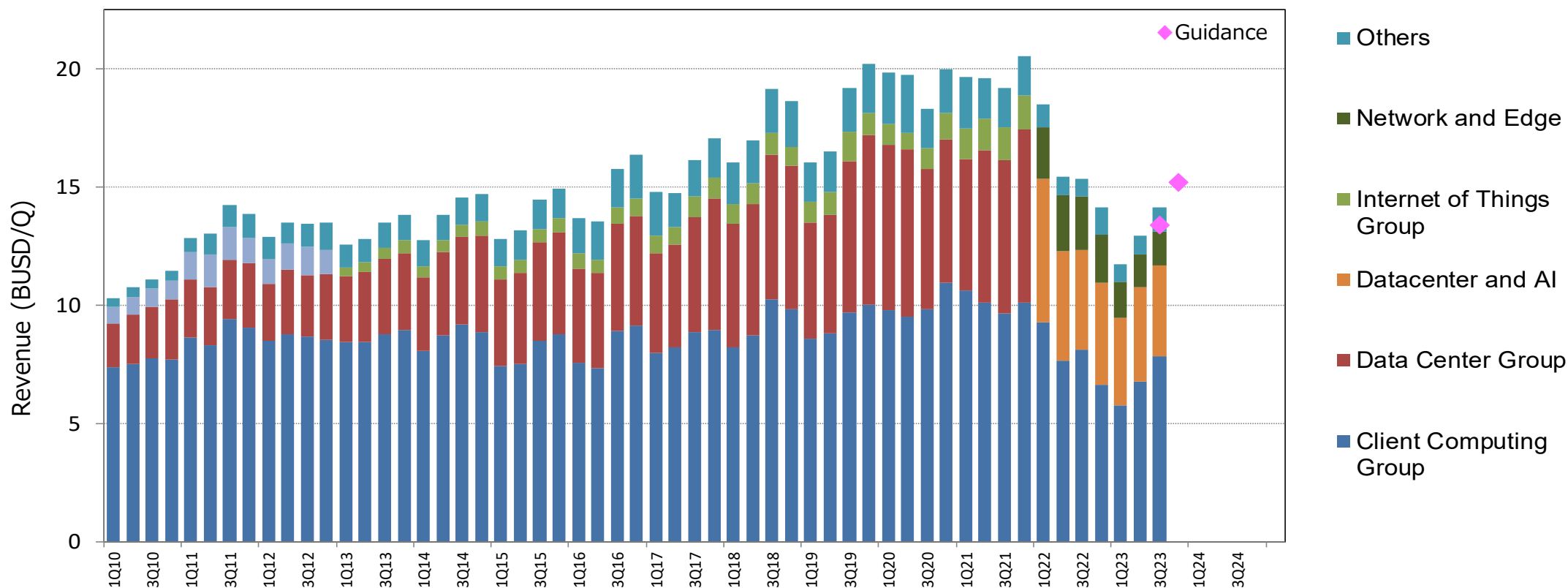


《暦年ベース》

Intel 売上高 (2023年7-9月期)

出所：Intel公開情報よりフジミ作成

- 23年3Q (7-9月期) 売上高 QoQ +9%, YoY -8%
PC向けの売上高がQoQで増加
- 23年4Q (10-12月期) ガイダンスでは、売上高 QoQ +3~10%

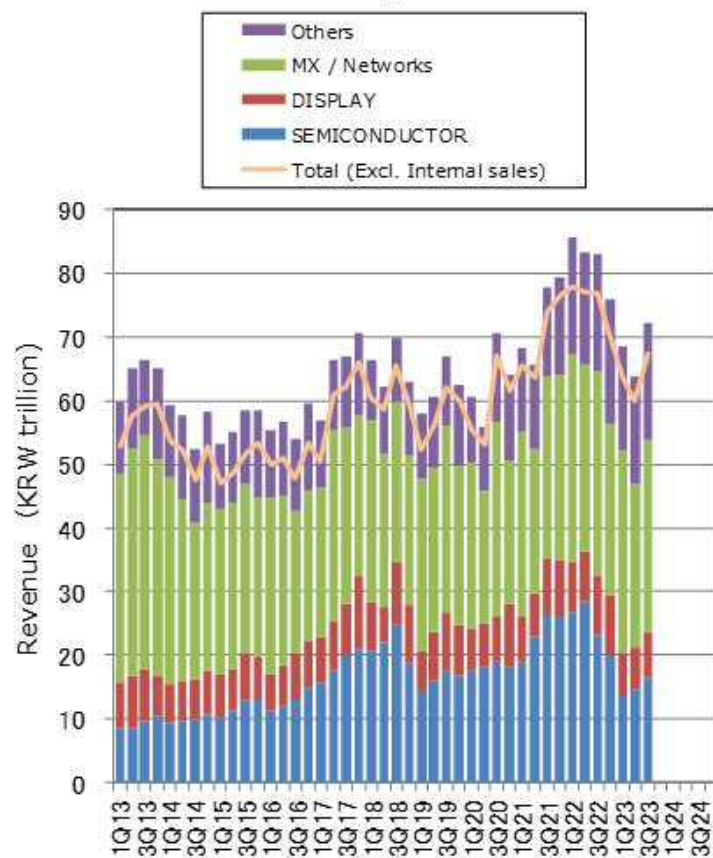


サムスン電子 売上高 (2023年7-9月期)

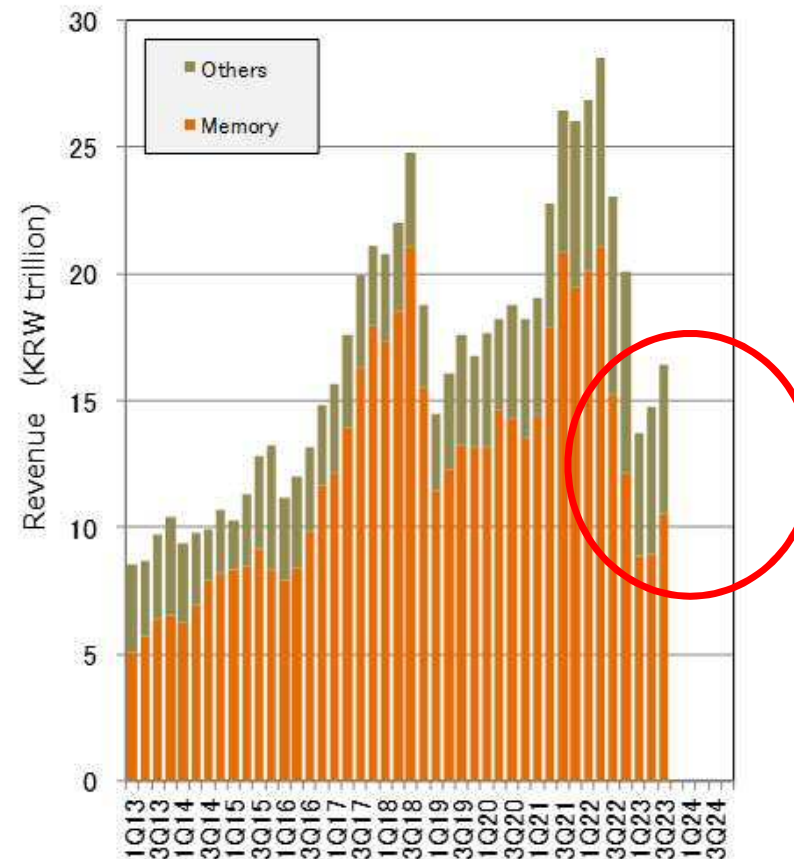
出所：サムスン電子公開情報よりフジミ作成

- 半導体事業の23年3Q (7-9月期) 売上高 QoQ +12%, YoY -29%
- メモリ：サーバー向け需要は引き続き弱いものの、生成AI向け製品が売上回復に寄与

<Samsung Total>



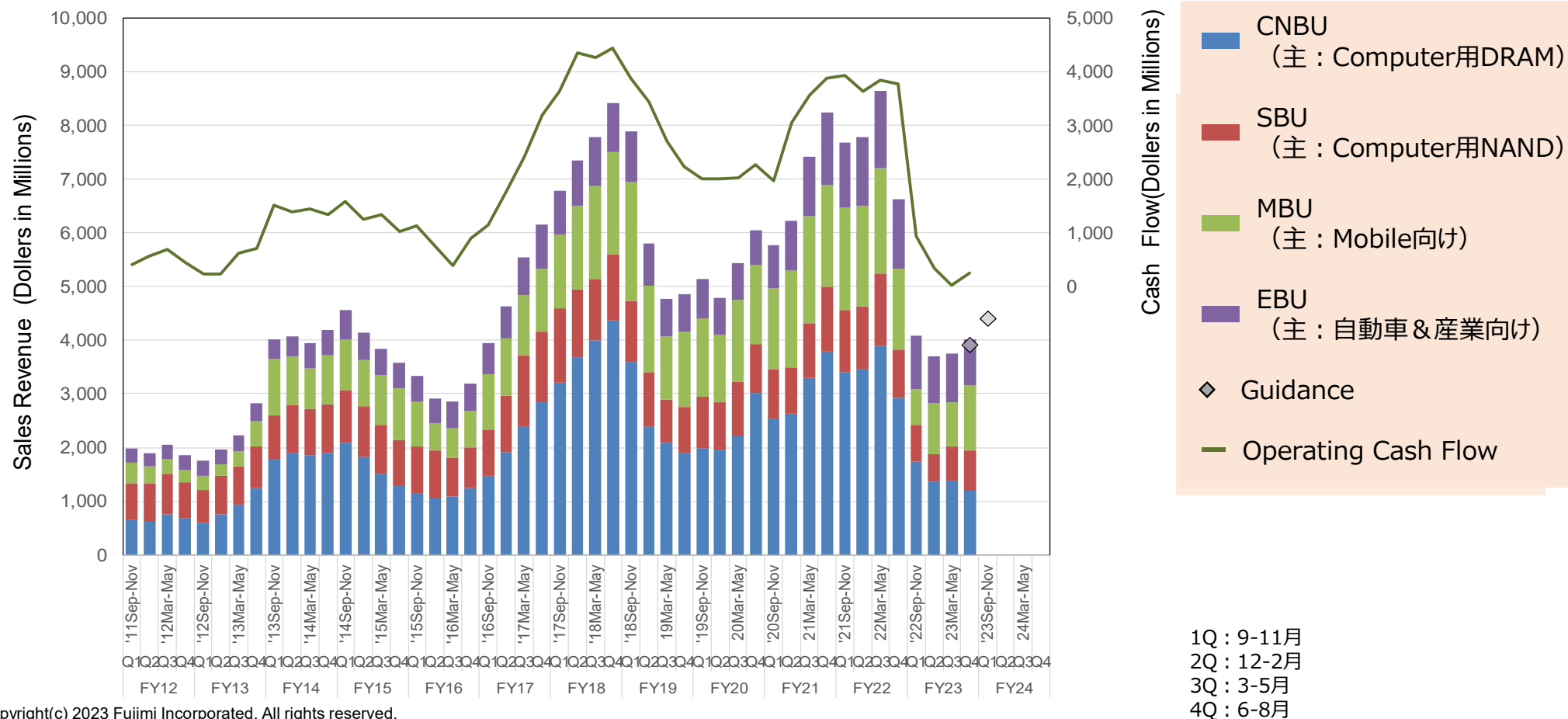
<Semiconductor Division>



マイクロン・テクノロジー 売上高 (2023年6月-2023年8月期)

出所：マイクロン・テクノロジー公開情報よりフジミ作成

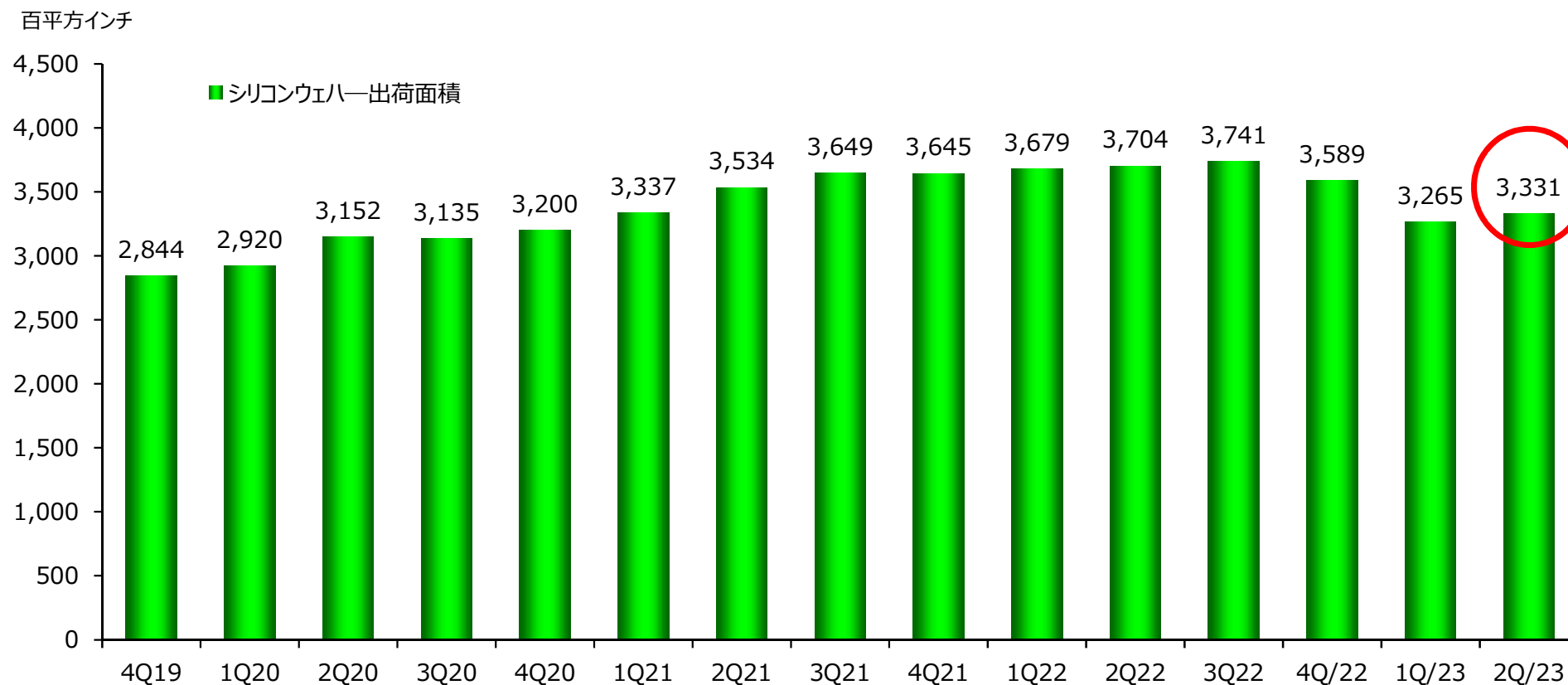
- 23年6-8月期 売上高 QoQ +7%, YoY -40%
- 23年9-11月期 ガイダンスでは、売上高 QoQ +5~15%



シリコンウェハー出荷面積 実績 (四半期)

出所：SEMI (2023/7/25)

- 半導体市場の在庫調整が続く中、23年2Q (4-6月期) のウェハー出荷面積は、QoQ +2%, YoY -10%

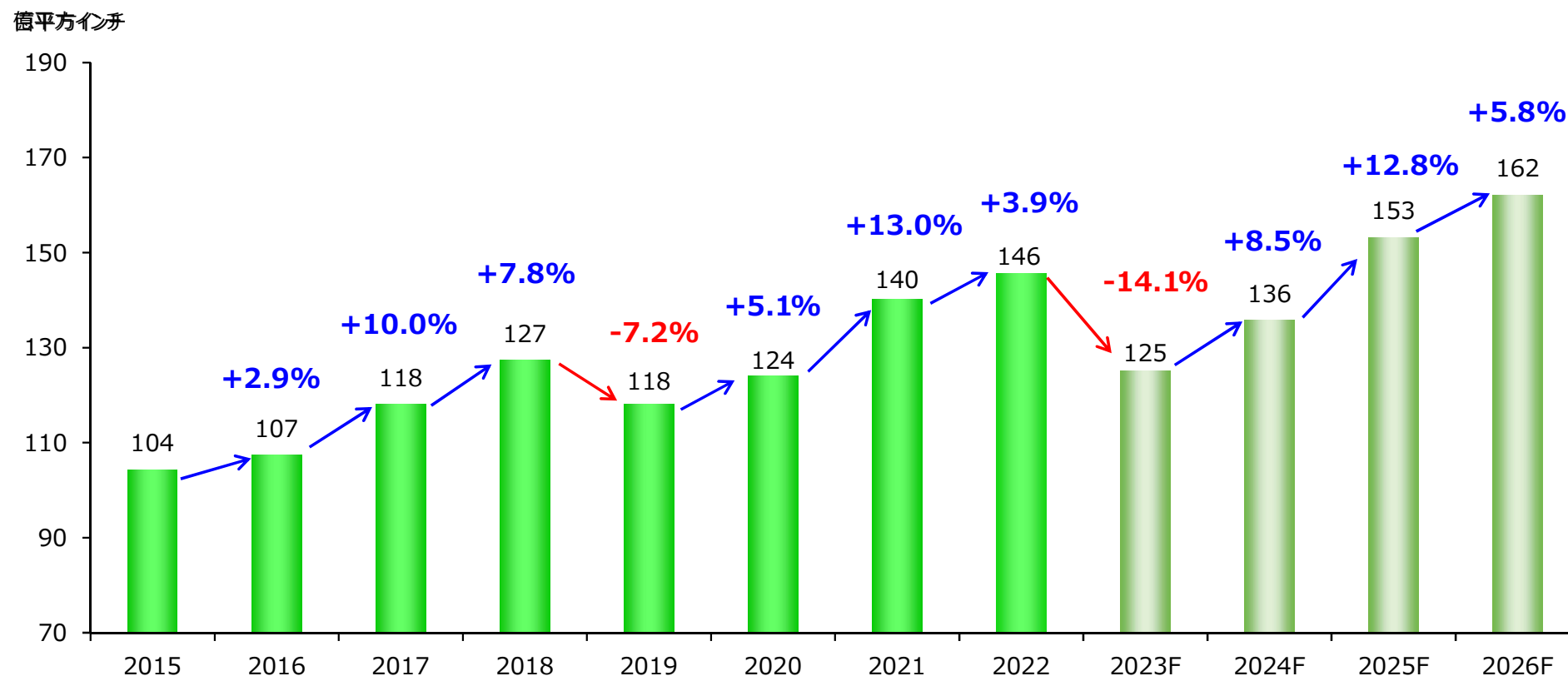


《暦年ベース》

シリコンウェハー需要予測（出荷面積換算 全口径）

出所：SEMI（実績 2023/2/16 予測 2023/10/26）

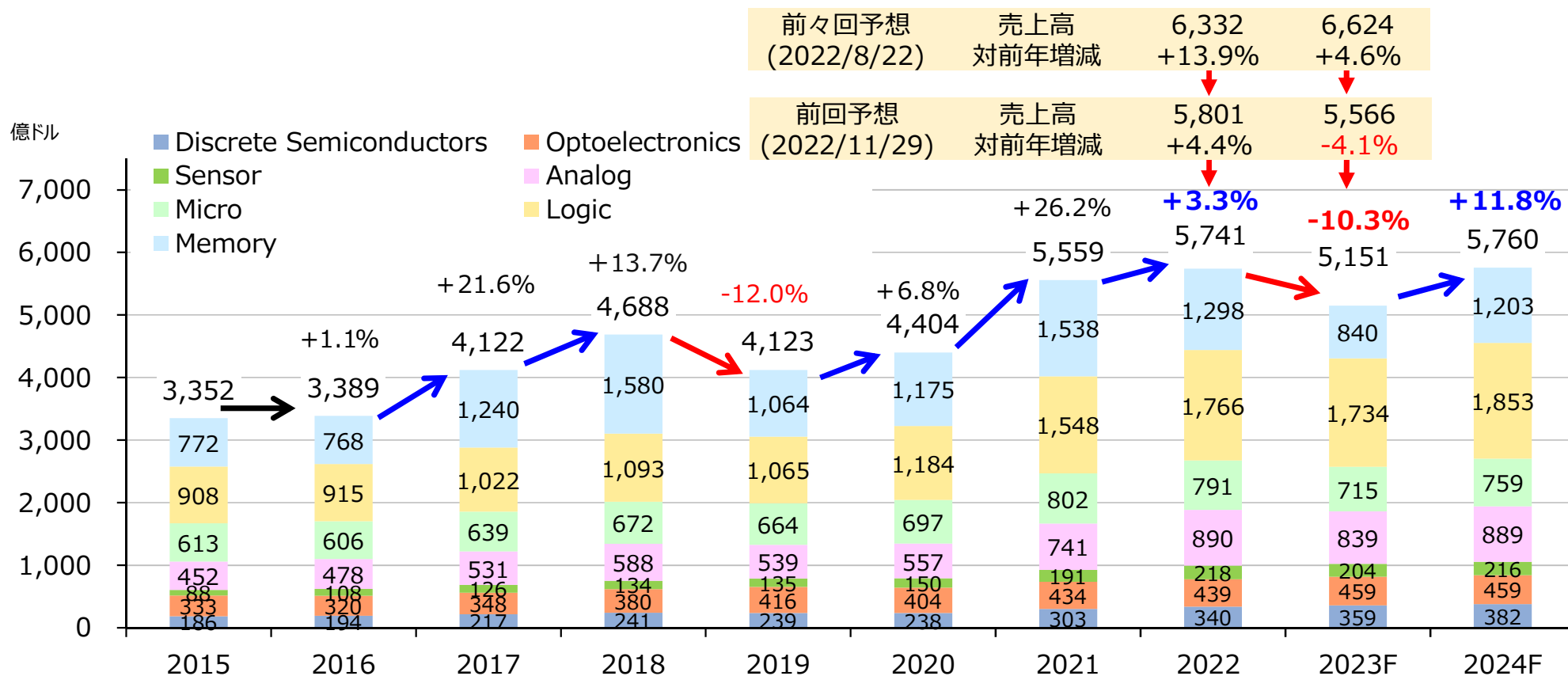
- 2023年、シリコンウェハー需要はマイナス成長の予測 YoY -14.1%



世界半導体市場動向（年次 WSTS予測） 用途別

出所：WSTS（2023/6/6）

- 2023年の市場予想は、PC・スマホ等の需要低迷により、2022年11月に4.6%から-4.1%へマイナス成長に下方修正、更に6月においても-10.3%へ下方修正
- 2024年の市場予想は、世界景気が回復に向かうという前提の下、+11.8%を見込む



《暦年ベース》

決算概要

決算概要（上期実績）

単位：百万円

	23年3月期		24年3月期				
	上期実績	下期実績	上期予想 ('23/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('23/5)
売上高	31,097	27,296	27,500	25,352	△18.5%	△7.1%	△7.8%
営業利益 率	7,819 25.1%	5,423 19.9%	5,400 19.6%	3,949 15.6%	△49.5% -	△27.2% -	△26.9% -
経常利益 率	8,293 26.7%	5,301 19.4%	5,500 20.0%	4,430 17.5%	△46.6% -	△16.4% -	△19.4% -
四半期純利益 率	6,155 19.8%	4,439 16.3%	4,100 14.9%	3,377 13.3%	△45.1% -	△23.9% -	△17.6% -

・期初予想比 売上高・利益ともに下回った

- 昨年秋以降の半導体デバイスの生産及び在庫の調整が想定以上に長期化
- 大口径シリコンウェハも第1四半期に調整が始まり、第2四半期では減速感が強まった
- 上記より半導体関連製品の販売が減少

・為替実績：141円/ドル（前期上期：133円/ドル）

・EBITDAマージン：19.4%（前期上期：27.8%）

業績予想（下期予想）

単位：百万円

	23年3月期		24年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 ('23/5)	下期修正予想 ('23/11)	前年同期比	同年上期比	期初予想比 ('23/5)
売上高	31,097	27,296	25,352	31,000	24,148	△11.5%	△4.8%	△22.1%
営業利益 率	7,819 25.1%	5,423 19.9%	3,949 15.6%	7,100 22.9%	3,151 13.0%	△41.9% -	△20.2% -	△55.6% -
経常利益 率	8,293 26.7%	5,301 19.4%	4,430 17.5%	7,200 23.2%	3,220 13.3%	△39.3% -	△27.3% -	△55.3% -
四半期純利益 率	6,155 19.8%	4,439 16.3%	3,377 13.3%	5,500 17.7%	2,423 10.0%	△45.4% -	△28.3% -	△56.0% -

・期初予想比 売上高・利益ともに下回る

- 期初予想では、10月以降の半導体市場の回復を想定

- 修正予想では、半導体市場の調整は継続し、本格的な回復には時間を要すると想定

・想定為替レート：140円／ドル（前期下期実績：138円／ドル）

・EBITDAマージン：17.7%（前期下期：23.2%）

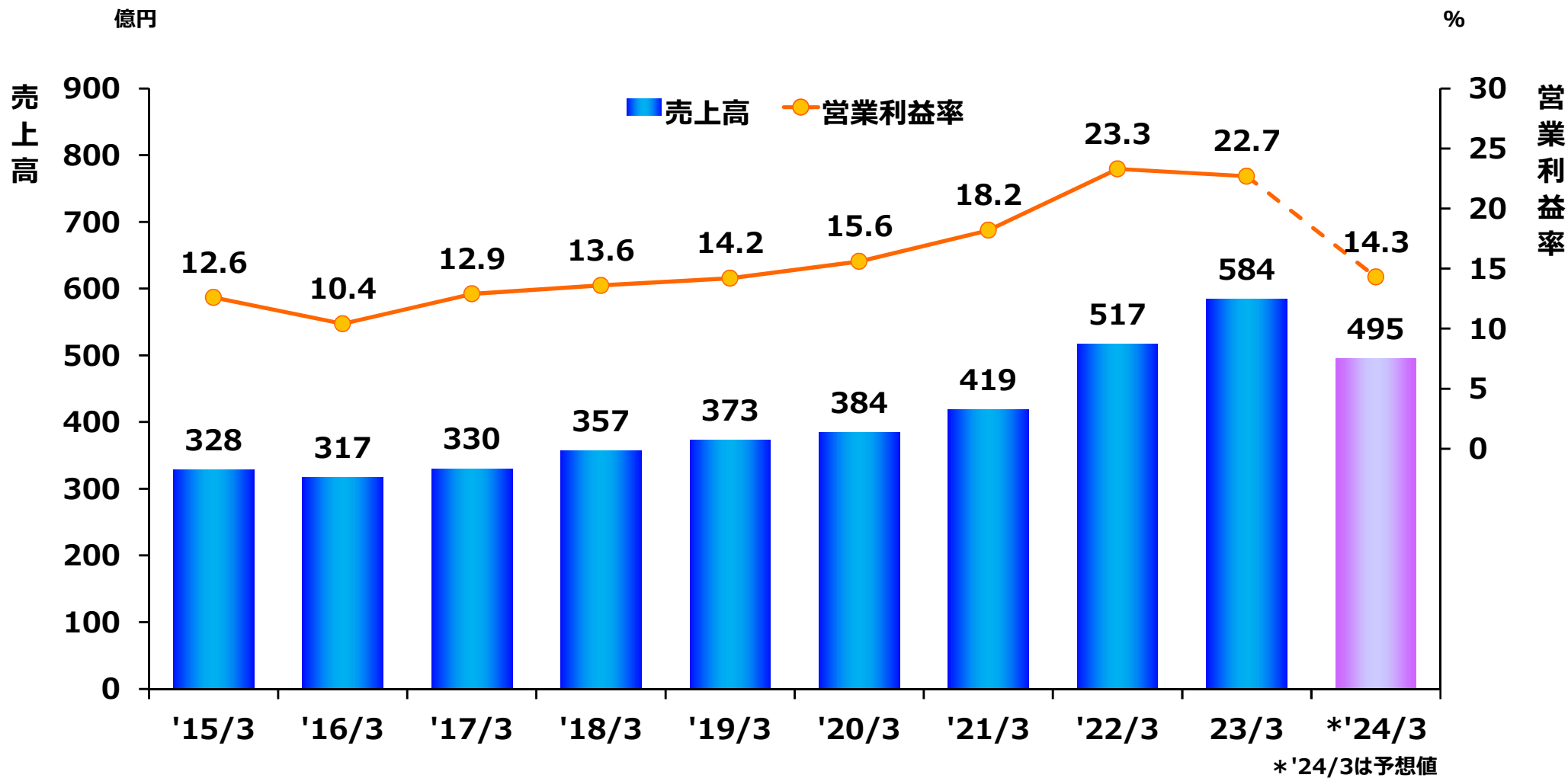
業績予想 (通期予想)

単位：百万円

	23年3月期	24年3月期			
	通期実績	期初予想 ('23/5)	修正予想 ('23/11)	前期比	期初予想比 ('23/5)
売上高	58,394	58,500	49,500	△15.2%	△15.4%
営業利益 率	13,243 22.7%	12,500 21.4%	7,100 14.3%	△46.4% -	△43.2% -
経常利益 率	13,595 23.3%	12,700 21.7%	7,650 15.5%	△43.7% -	△39.8% -
当期純利益 率	10,594 18.1%	9,600 16.4%	5,800 11.7%	△45.3% -	△39.6% -

・減収減益予想 売上高 前年比△15.2% 営業利益 △46.4%
 - シリコン売上高予想：前年比△24.9% 上下比△13.2%
 シリコンウェハーの減速感は2Qに強まり、3Q以降も2Qの水準で推移すると想定し、上下比で減少
 - CMP売上高予想：前年比△9.7% 上下比△0.2%
 半導体市場の本格的な回復には時間を要すると想定し、CMP売上高は上下比で横ばいを見込む
 ・EBITDAマージン：18.6%（前期：25.6%）

業績推移 (今期予想含む)



用途別売上高

用途別売上高（上期実績）

単位：百万円

		23年3月期		24年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想 ('23/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('23/5)
シリコンウエハー	ラッピング	3,507	3,546	3,400	2,818	△19.6%	△20.5%	△17.1%
	ポリシング	7,011	6,598	6,500	5,487	△21.7%	△16.8%	△15.6%
	切断	109	129	100	98	△10.3%	△24.0%	△1.4%
	計	10,629	10,275	10,000	8,404	△20.9%	△18.2%	△16.0%
CMP		15,766	12,901	12,900	12,962	△17.8%	+0.5%	+0.5%
ディスク	アルミディスク	987	480	700	467	△52.7%	△2.9%	△33.3%
	ガラスディスク	14	23	0	3	△75.8%	△84.3%	-
	計	1,002	503	700	470	△53.1%	△6.6%	△32.8%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,298	2,312	2,600	2,229	△3.0%	△3.6%	△14.3%
	一般工業用(非研磨材)	1,330	1,270	1,250	1,251	△5.9%	△1.5%	+0.1%
	計	3,628	3,583	3,850	3,480	△4.1%	△2.9%	△9.6%
製品売上高		31,026	27,264	27,450	25,318	△18.4%	△7.1%	△7.8%
商品売上高		70	32	50	34	△50.9%	+5.8%	△30.6%
売上高 合計		31,097	27,296	27,500	25,352	△18.5%	△7.1%	△7.8%

用途別売上高（通期予想）

単位：百万円

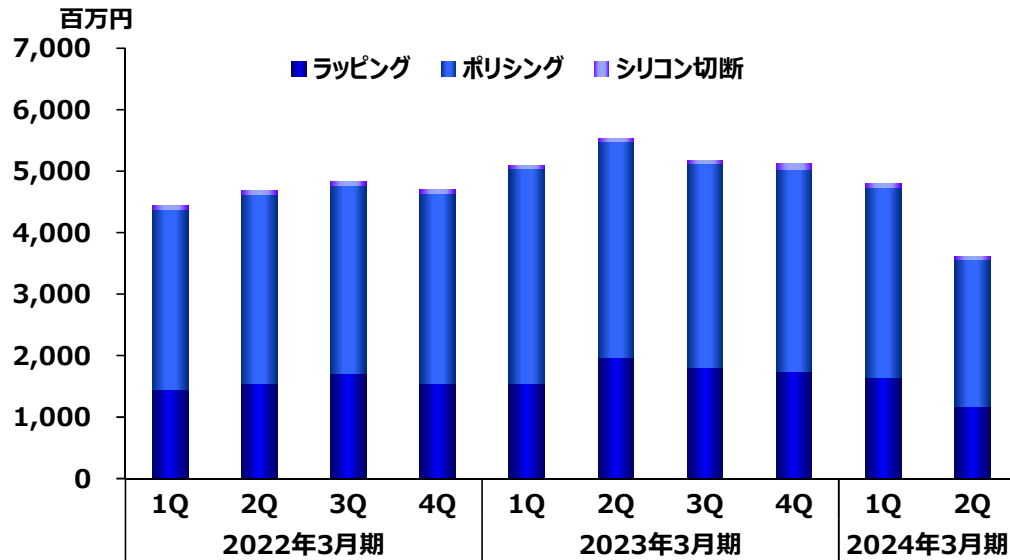
		22年3月期	23年3月期	24年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想 ('23/5)	通期 修正予想 ('23/11)	前期比	期初予想比 ('23/5)
シリコンウエハー	ラッピング	6,249	7,054	7,300	5,174	△26.7%	△29.1%
	ポリシング	12,149	13,610	14,000	10,328	△24.1%	△26.2%
	切断	266	239	200	197	△17.8%	△1.5%
	計	18,665	20,904	21,500	15,700	△24.9%	△27.0%
CMP		24,571	28,668	27,100	25,900	△9.7%	△4.4%
ディスク	アルミディスク	1,684	1,468	1,700	1,145	△22.0%	△32.6%
	ガラスディスク	41	37	0	5	△86.8%	-
	計	1,725	1,506	1,700	1,150	△23.7%	△32.4%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	4,408	4,610	5,400	4,200	△8.9%	△22.2%
	一般工業用(非研磨材)	2,192	2,601	2,700	2,450	△5.9%	△9.3%
	計	6,600	7,211	8,100	6,650	△7.8%	△17.9%
製品売上高		51,564	58,290	58,400	49,400	△15.3%	△15.4%
商品売上高		167	103	100	100	△3.4%	+0.0%
売上高 合計		51,731	58,394	58,500	49,500	△15.2%	△15.4%

シリコンウェハー売上高（上期実績）

《上期》

単位：百万円

		23年3月期		24年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想 ('23/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('23/5)
シリコンウェハー	ラッピング	3,507	3,546	3,400	2,818	△19.6%	△20.5%	△17.1%
	ポリシング	7,011	6,598	6,500	5,487	△21.7%	△16.8%	△15.6%
	切断	109	129	100	98	△10.3%	△24.0%	△1.4%
	計	10,629	10,275	10,000	8,404	△20.9%	△18.2%	△16.0%



・ 事業環境

- 大口径シリコンウェハーは第1四半期に調整が始まり、第2四半期では減速感が強まった
- ・ ラッピング、ポリシング製品の減収要因
 - 上記要因による需要減少

シリコンウェハ―売上高（下期予想・通期予想）

シリコンウェハ―の生産における本格的な回復には時間を要するものと想定し、上下比で減少を見込む

「下期」

単位：百万円

		23年3月期		24年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 ('23/5)	下期修正予想 ('23/11)	前年同期比	上期比	期初予想比 ('23/5)
シリコンウェハ―	ラッピング	3,507	3,546	2,818	3,900	2,356	△33.6%	△16.4%	△39.6%
	ポリシング	7,011	6,598	5,487	7,500	4,841	△26.6%	△11.8%	△35.5%
	切断	109	129	98	100	98	△24.4%	△0.6%	△2.0%
	計	10,629	10,275	8,404	11,500	7,296	△29.0%	△13.2%	△36.6%

「通期」

単位：百万円

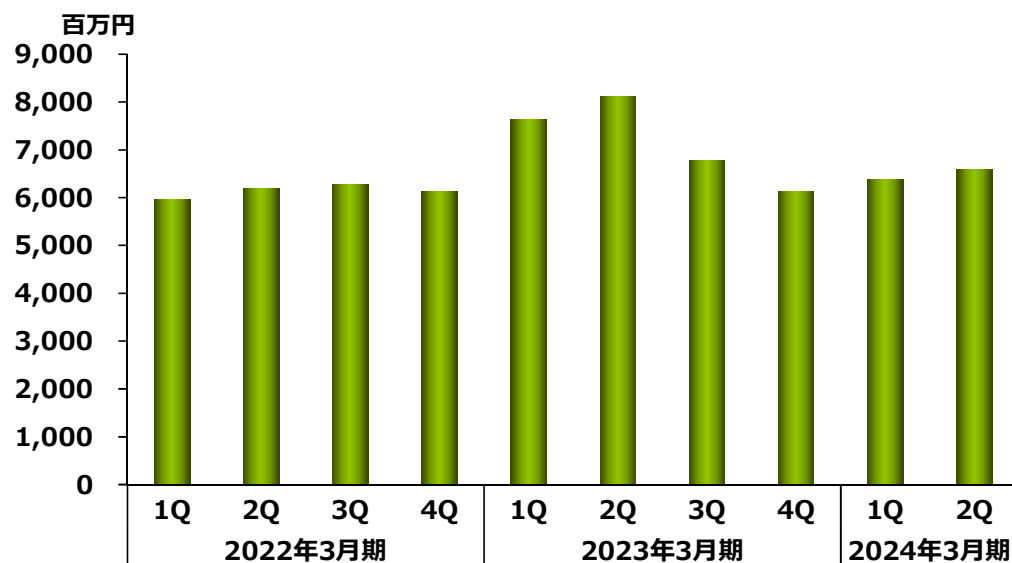
		22年3月期	23年3月期	24年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想 ('23/5)	通期修正予想 ('23/11)	前期比	期初予想比 ('23/5)
シリコンウェハ―	ラッピング	6,249	7,054	7,300	5,174	△26.7%	△29.1%
	ポリシング	12,149	13,610	14,000	10,328	△24.1%	△26.2%
	切断	266	239	200	197	△17.8%	△1.5%
	計	18,665	20,904	21,500	15,700	△24.9%	△27.0%

CMP売上高（上期実績）

«上期»

単位：百万円

	23年3月期		24年3月期				
	上期実績	下期実績	上期予想 ('23/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('23/5)
CMP	15,766	12,901	12,900	12,962	△17.8%	+0.5%	+0.5%



- ・ 事業環境
 - PC、スマートフォン及びサーバー市場の低迷に伴い、ロジック、メモリデバイスともに需要は軟調、在庫も増加
 - 一方で、先端ロジックデバイスでは量産化が進展
- ・ CMP向け製品の減収要因
 - 先端ロジックの量産が進み、QoQでは1Q, 2Qともに微増も、マチュアロジック、メモリでの稼働調整色が強まった

CMP売上高（下期予想・通期予想）

・半導体市場の本格的な回復には時間を要すると想定し、CMP売上高は上下比で横ばいを見込む

「下期」

単位：百万円

	23年3月期		24年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 ('23/5)	下期修正予想 ('23/11)	前年同期比	上期比	期初予想比 ('23/5)
CMP	15,766	12,901	12,962	14,200	12,938	+0.3%	△0.2%	△8.9%

「通期」

単位：百万円

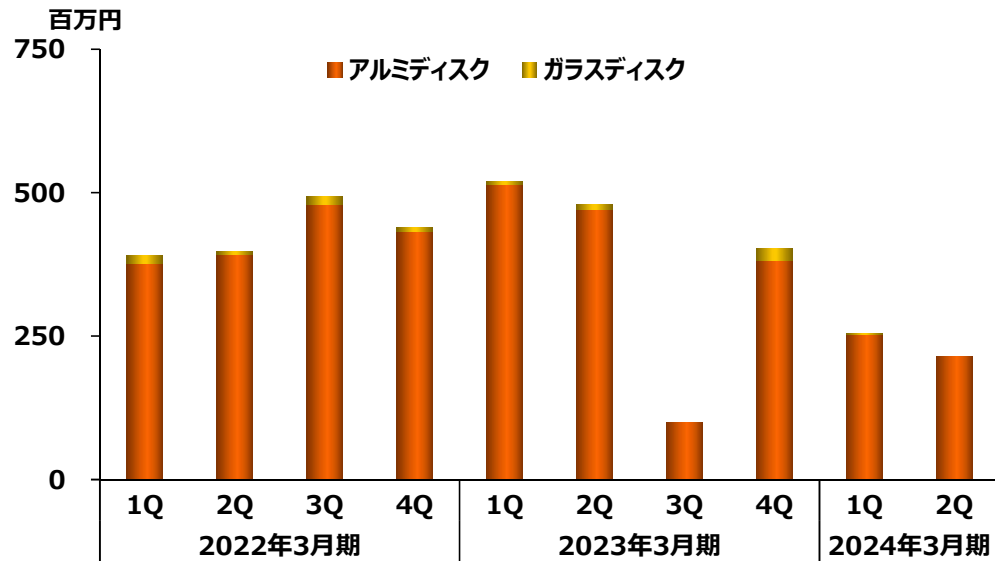
	22年3月期	23年3月期	24年3月期			
	通期実績	通期実績	通期予想 ('23/5)	通期修正予想 ('23/11)	前期比	期初予想比 ('23/5)
CMP	24,571	28,668	27,100	25,900	△9.7%	△4.4%

ディスク売上高（上期実績）

《上期》

単位：百万円

		23年3月期		24年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想 ('23/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('23/5)
ディスク	アルミディスク	987	480	700	467	△52.7%	△2.9%	△33.3%
	ガラスディスク	14	23	0	3	△75.8%	△84.3%	-
	計	1,002	503	700	470	△53.1%	△6.6%	△32.8%



- ・ 事業環境
 - HDDからSSDへの移行
 - HDDの生産及び在庫の調整継続
- ・ アルミディスク向け製品の減収要因
 - 上記要因により需要減少

ディスク売上高（下期予想・通期予想）

・ HDD市況は低調であるものの、下期においては顧客の稼働改善を見込む

「下期」

単位：百万円

		23年3月期		24年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 ('23/5)	下期修正予想 ('23/11)	前年同期比	上期比	期初予想比 ('23/5)
ディスク	アルミディスク	987	480	467	1,000	678	+41.0%	+45.2%	△32.2%
	ガラスディスク	14	23	3	0	2	△91.3%	△44.8%	-
	計	1,002	503	470	1,000	680	+34.9%	+44.5%	△32.0%

「通期」

単位：百万円

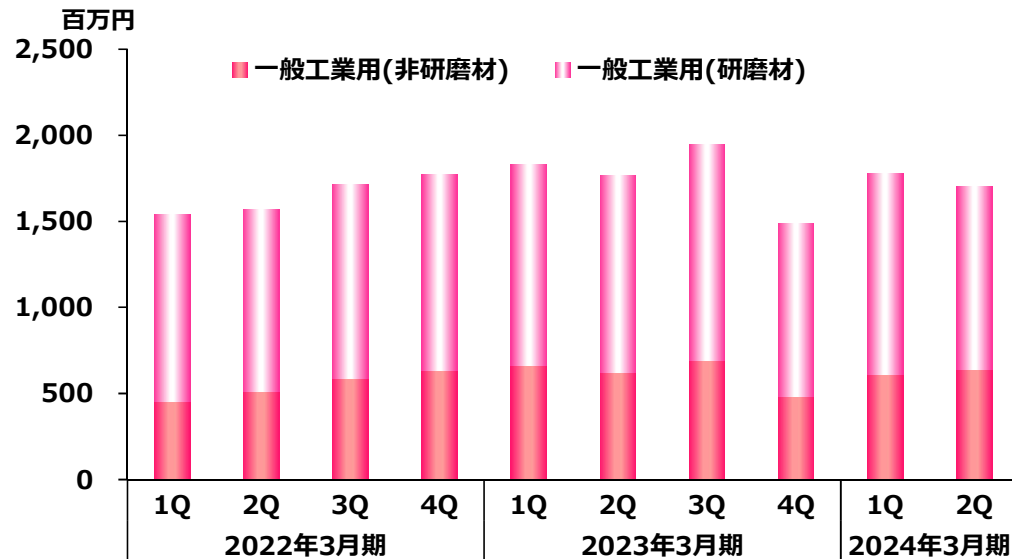
		22年3月期	23年3月期	24年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想 ('23/5)	通期修正予想 ('23/11)	前期比	期初予想比 ('23/6)
ディスク	アルミディスク	1,684	1,468	1,700	1,145	△22.0%	△32.6%
	ガラスディスク	41	37	0	5	△86.8%	-
	計	1,725	1,506	1,700	1,150	△23.7%	△32.4%

機能材・溶射材売上高（上期実績）

《上期》

単位：百万円

		23年3月期		24年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想 ('23/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('23/5)
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,298	2,312	2,600	2,229	△3.0%	△3.6%	△14.3%
	一般工業用(非研磨材)	1,330	1,270	1,250	1,251	△5.9%	△1.5%	+0.1%
	計	3,628	3,583	3,850	3,480	△4.1%	△2.9%	△9.6%



- ・ 上期の事業環境
 - 産業機械向け需要の減少
 - 半導体製造装置の設備投資は調整局面
- ・ 一般工業用（研磨材）の減収要因
 - 上記要因により需要減少
- ・ 一般工業用（非研磨材）の減収要因
 - 上記要因により需要減少

機能材・溶射材売上高（下期予想・通期予想）

・ 各種用途において、需要の低迷が下期も継続すると想定

「下期」

単位：百万円

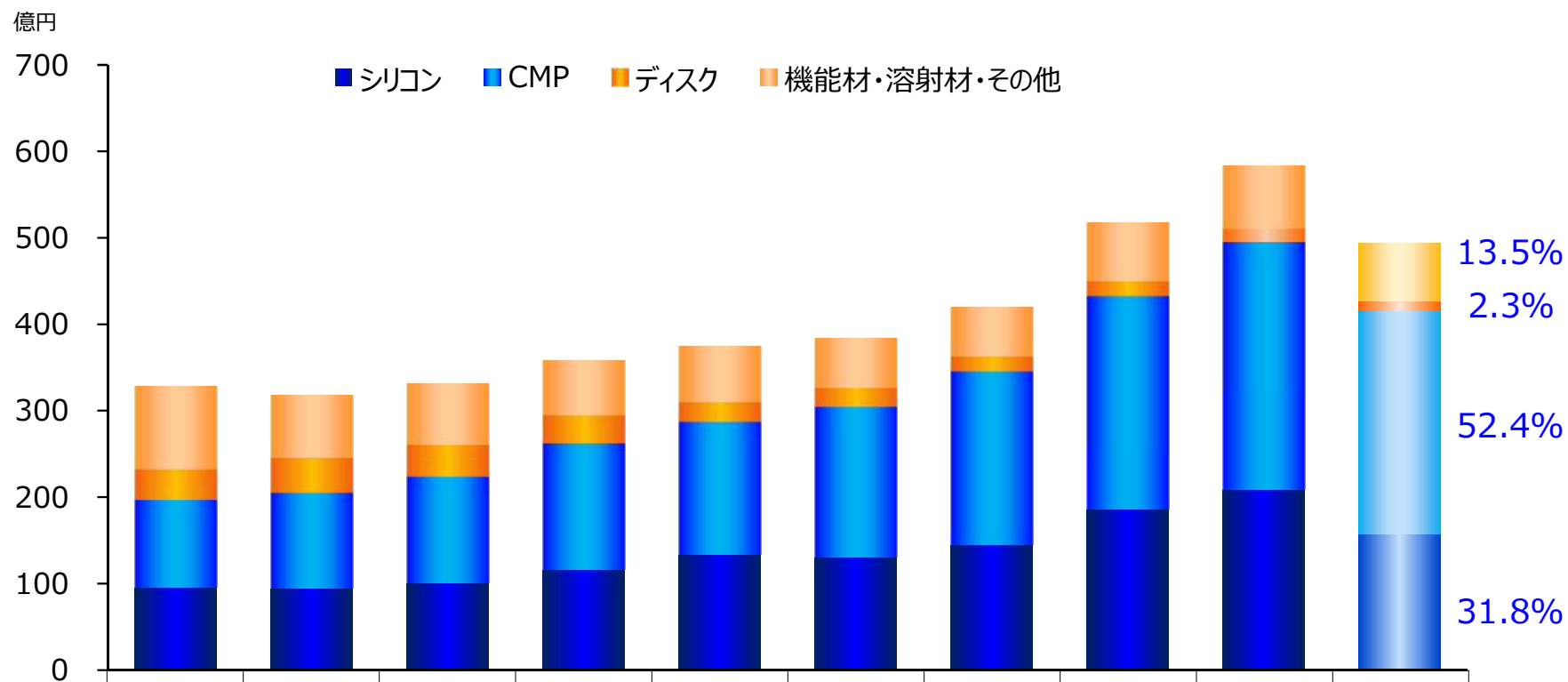
		23年3月期		24年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 ('23/5)	下期修正予想 ('23/11)	前年同期比	上期比	期初予想比 ('23/5)
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,298	2,312	2,229	2,800	1,971	△14.8%	△11.6%	△29.6%
	一般工業用(非研磨材)	1,330	1,270	1,251	1,450	1,197	△5.8%	△4.3%	△17.4%
	計	3,628	3,583	3,480	4,250	3,168	△11.6%	△9.0%	△25.5%

「通期」

単位：百万円

		22年3月期	23年3月期	24年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想 ('23/5)	通期修正予想 ('23/11)	前期比	期初予想比 ('23/5)
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	4,408	4,610	5,400	4,200	△8.9%	△22.2%
	一般工業用(非研磨材)	2,192	2,601	2,700	2,450	△5.9%	△9.3%
	計	6,600	7,211	8,100	6,650	△7.8%	△17.9%

用途別売上高（通期）



	'15/3	'16/3	'17/3	'18/3	'19/3	'20/3	'21/3	'22/3	'23/3	*'24/3
機能材・溶射材・その他	96	72	70	63	64	57	57	66	72	67
ディスク	34	40	36	32	22	21	17	17	15	12
CMP	101	109	122	146	153	173	200	245	286	259
シリコン	95	94	100	115	133	131	144	186	209	157
計	328	317	330	357	373	384	419	517	583	495

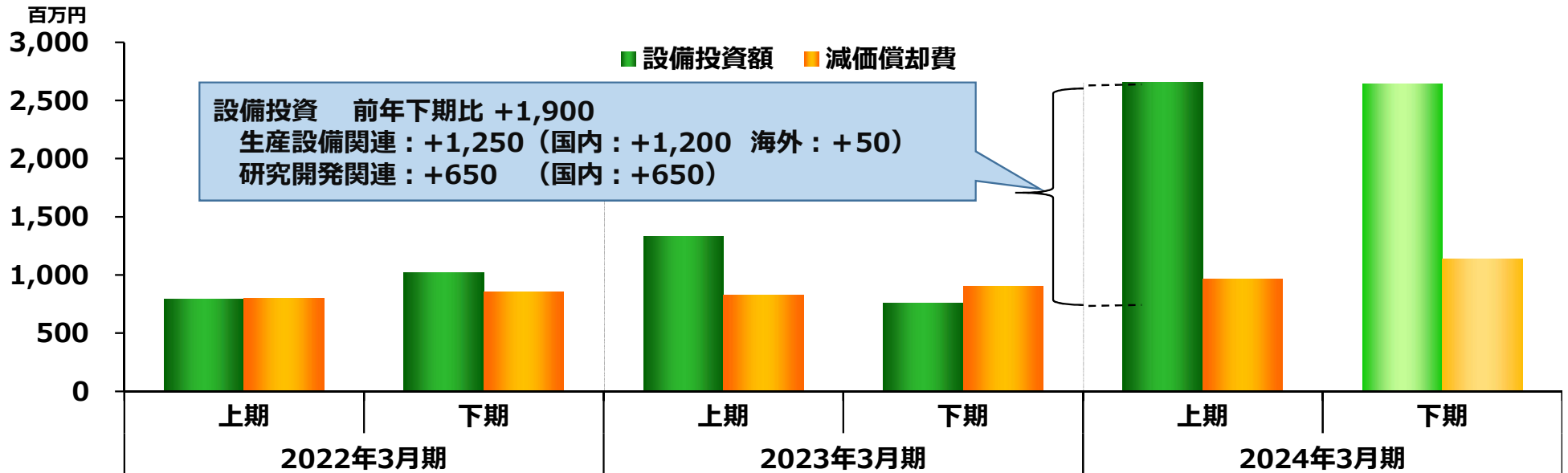
設備投資額
減価償却費
研究開発費

設備投資額・減価償却費（上期実績・下期計画）

単位：百万円

	23年3月期		24年3月期									
	上期実績	下期実績	上期計画 ('23/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	計画比 ('23/5)	下期計画 ('23/5)	下期修正計画 ('23/11)	前年同期比	同年上期比	計画比 ('23/5)
設備投資額	1,333	761	3,600	2,656	+99.3%	+248.7%	△26.2%	1,700	2,644	+247.4%	△0.4%	+55.5%
減価償却費	826	903	1,000	963	+16.6%	+6.7%	△3.6%	1,200	1,137	+25.9%	+18.0%	△5.2%

* 設備投資額は検収基準



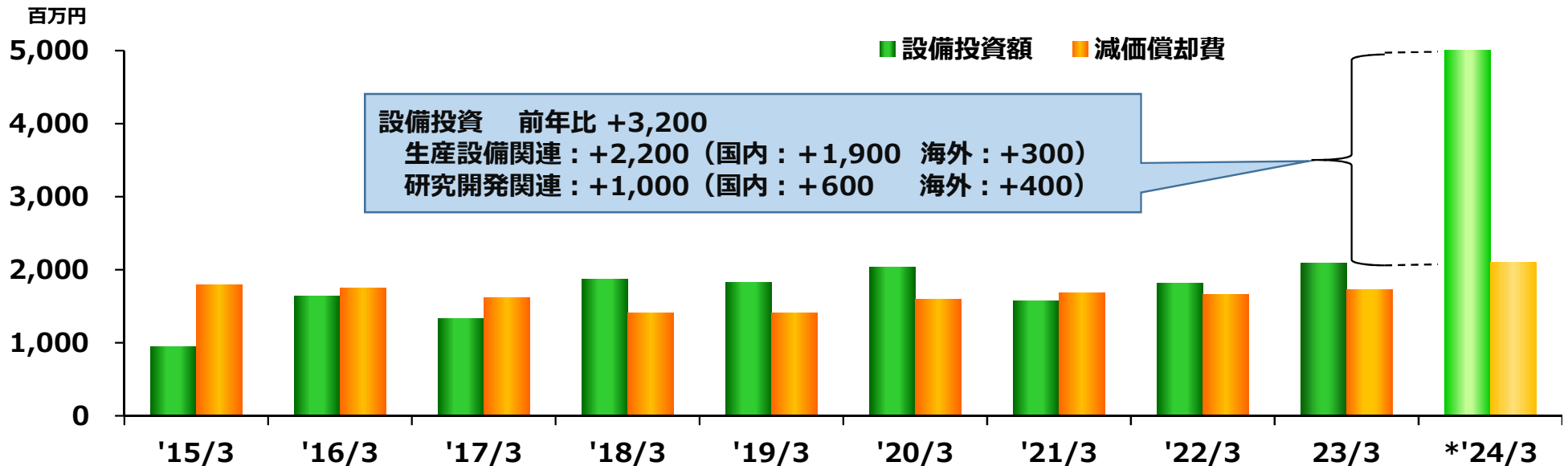
* '24/3下期は計画

設備投資額・減価償却費（通期実績・通期計画）

単位：百万円

	23年3月期	24年3月期			
	通期実績	通期計画 ('23/5)	通期修正計画 ('23/11)	前期比	期初計画比 ('23/5)
設備投資	2,094	5,300	5,300	+153.1%	+0.0%
減価償却費	1,729	2,200	2,100	+21.4%	△4.5%

* 設備投資額は検収基準

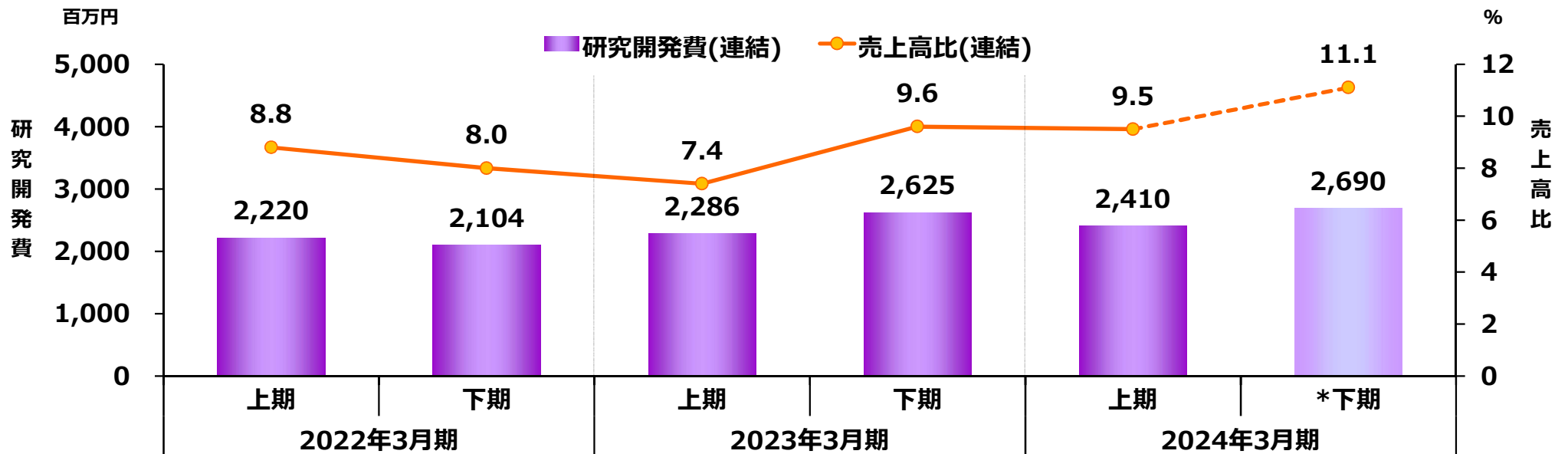


* '24/3は計画

研究開発費／売上高比（上期実績・下期計画）

単位：百万円

	23年3月期		24年3月期									
	上期実績	下期実績	上期計画 ('23/5)	上期実績			下期計画 ('23/5)	下期修正計画 ('23/11)				
				前年同期比	前年下期比	計画比 ('23/5)		前年同期比	同年上期比	計画比 ('23/5)		
研究開発費	2,286	2,625	2,600	2,410	+5.4%	△8.2%	△7.3%	2,600	2,690	+2.4%	+11.6%	+3.4%

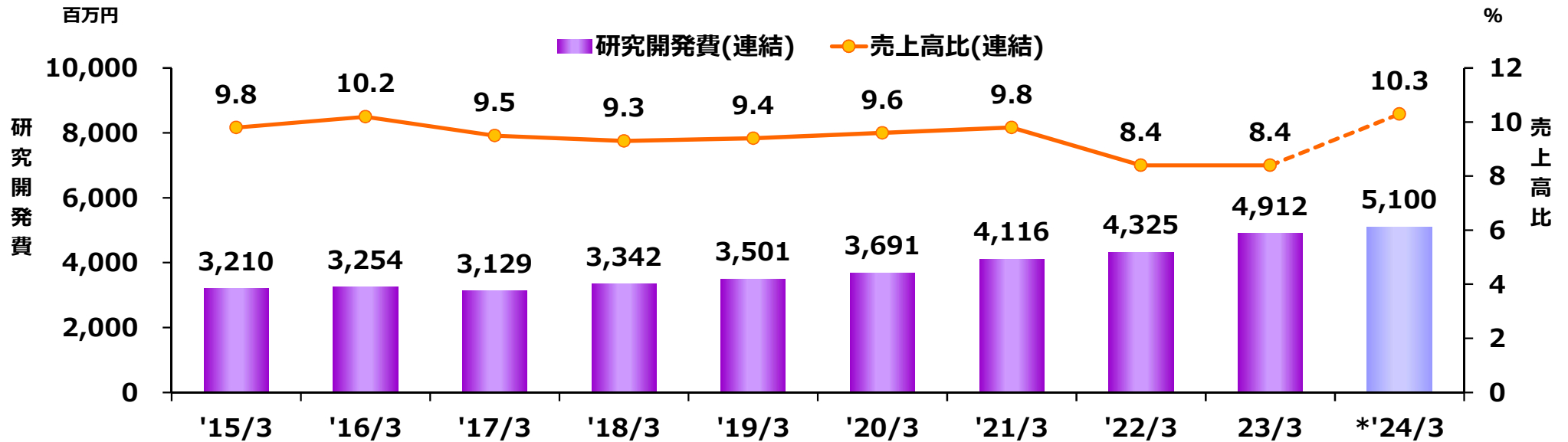


* '24/3下期は計画

研究開発費／売上高比（通期実績・通期計画）

単位：百万円

	23年3月期		24年3月期		
	通期実績	通期計画 ('23/5)	通期修正計画 ('23/11)	前期比	期初計画比 ('23/5)
研究開発費	4,912	5,200	5,100	+3.8%	△1.9%



*'24/3は計画

損益分析

営業利益増減要因 23/3期上期実績 → 24/3期上期実績

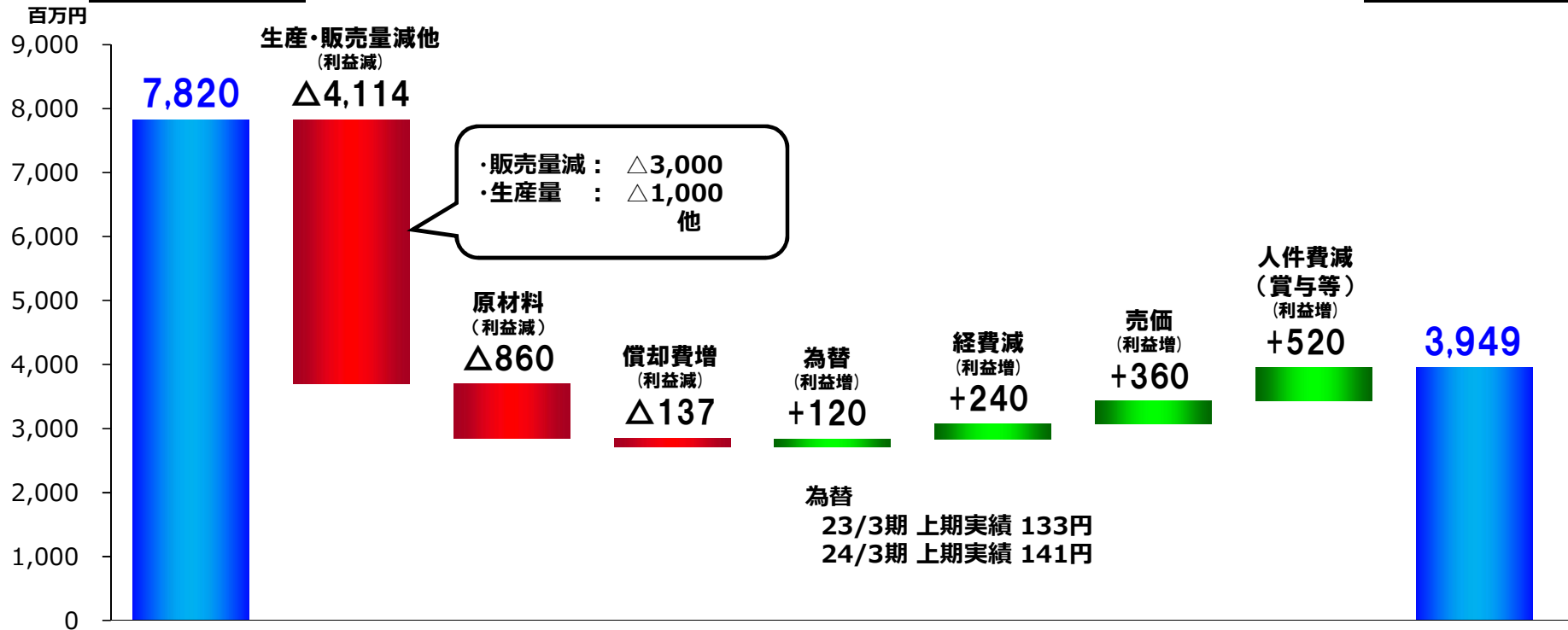
売上高 311億円

254億円

23/3期
上期実績

(売上減) $\Delta 5,744$ 百万円
(利益減) $\Delta 3,871$ 百万円

24/3期
上期実績



営業利益増減要因 24/3期上期実績 → 24/3期下期予想

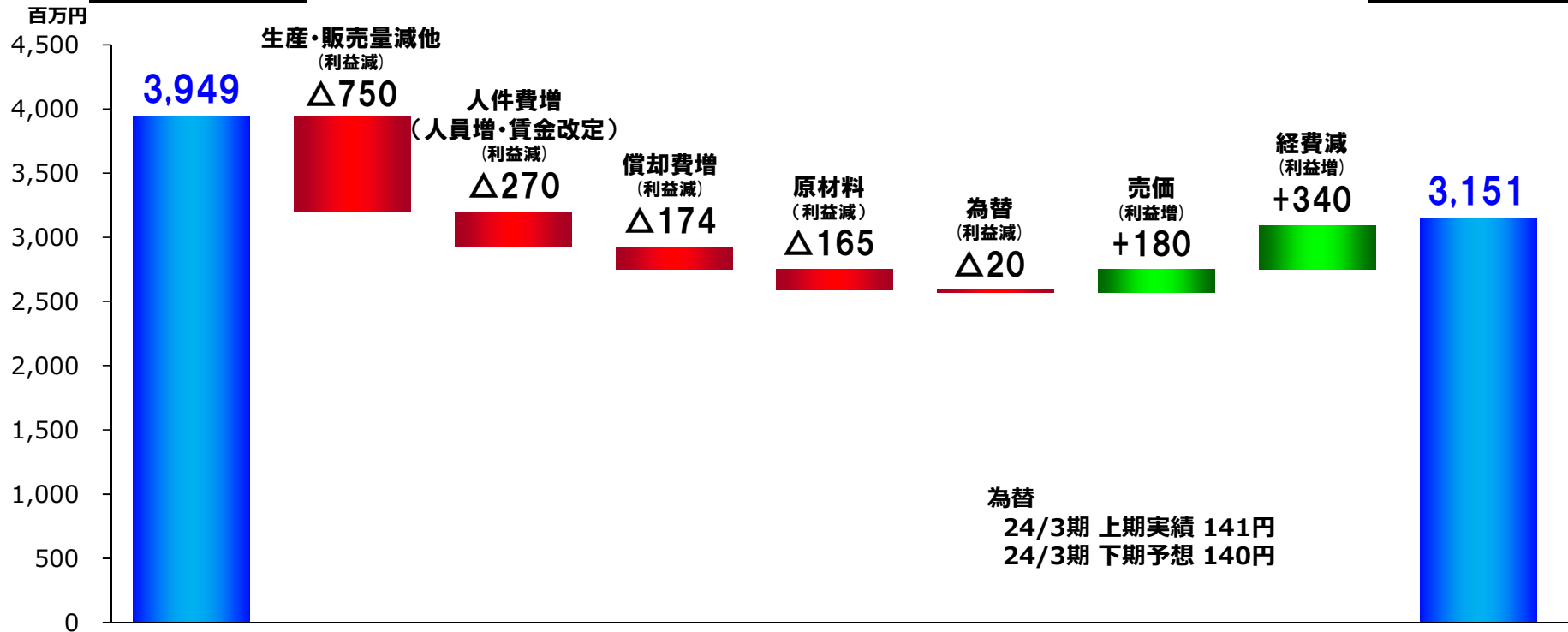
売上高 254億円

241億円

24/3期
上期実績

(売上減) Δ 1,205百万円
(利益減) Δ 798百万円

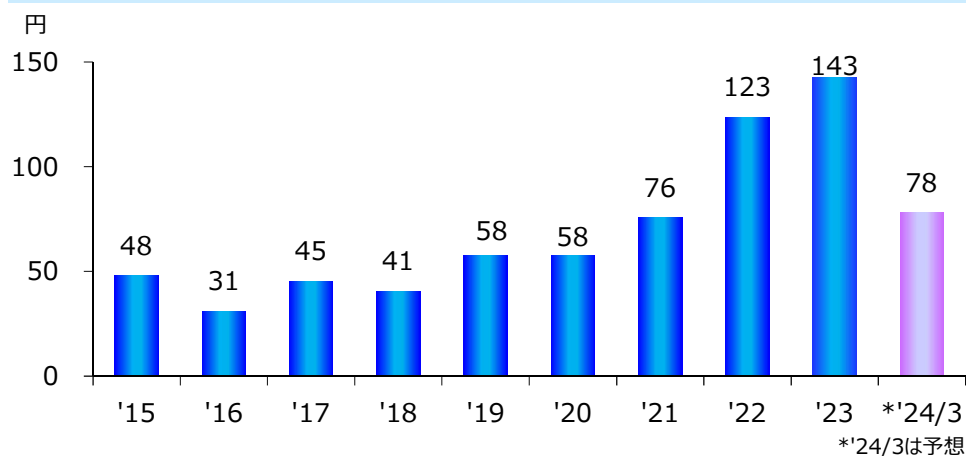
24/3期
下期予想



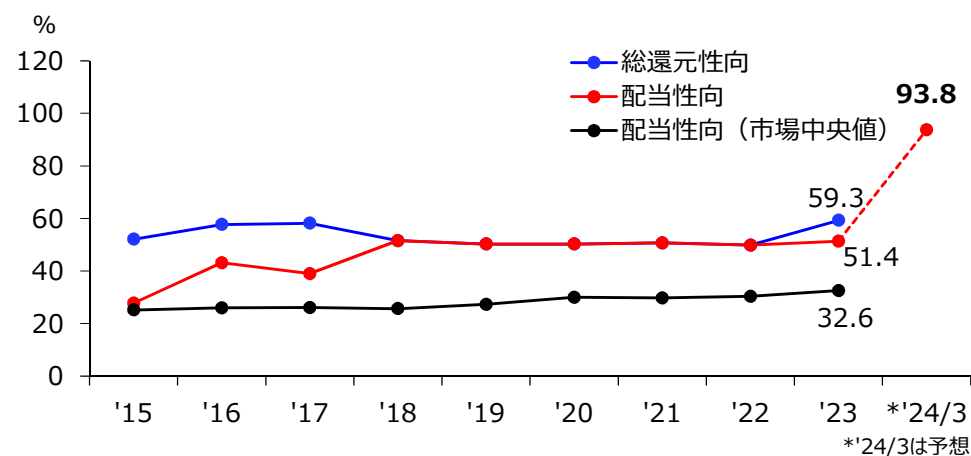
株主還元

積極的な株主還元と安定配当の継続

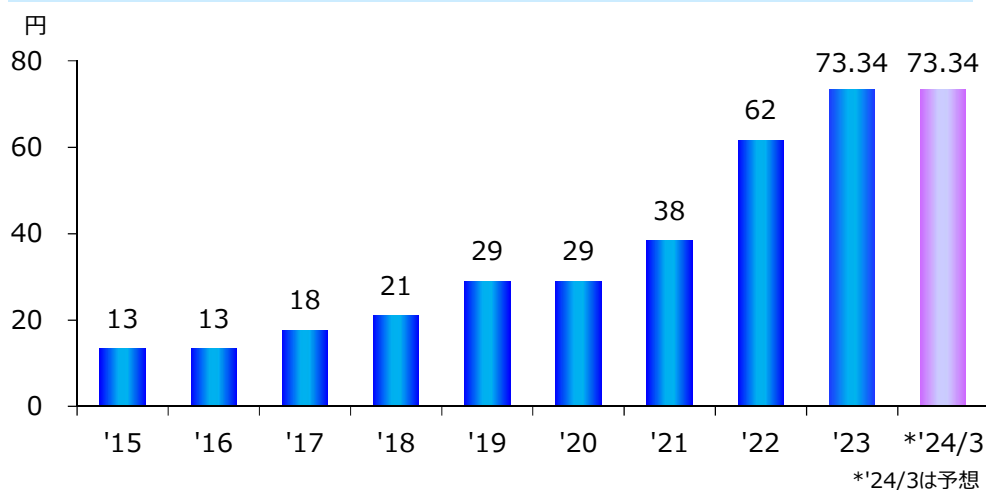
1株当たり当期純利益（分割後）



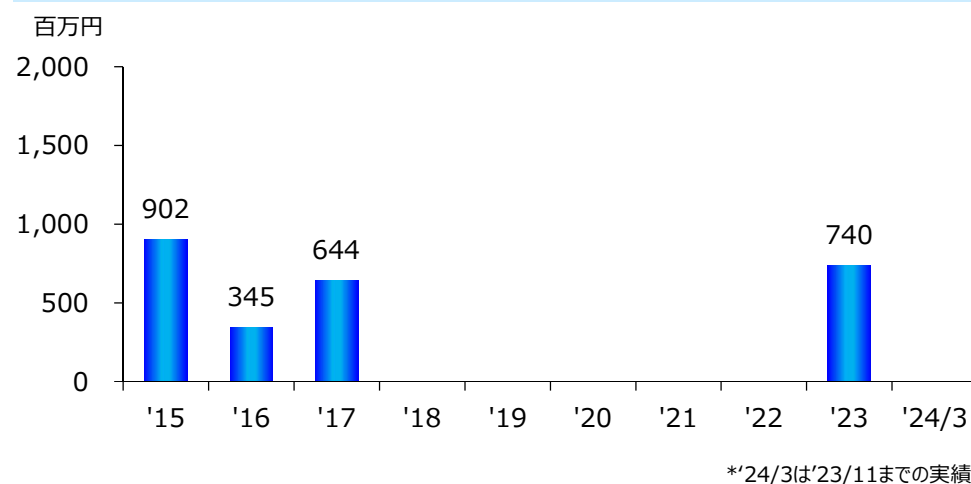
総還元性向・配当性向



1株当たり配当金（分割後）



自己株買い



2024年3月期 上期業績サマリー／下期業績予想

【2024年3月期 上期業績】 *前年同期比

✓ 売上高	*△18.5%	: 半導体デバイス向けCMP製品・シリコンウェハー向け製品の販売が減少
✓ 営業利益	△49.5%	: 半導体向け製品の販売減少に加え、原材料価格等が上昇
✓ 経常利益	△46.6%	:
✓ 四半期純利益	△45.1%	:
✓ シリコンウェハー向け	△20.9%	: 大口径シリコンウェハーは第1四半期に調整が始まり、第2四半期では減速感が強まり、減収
✓ CMP向け	△17.8%	: 先端ロジックの量産が進み1Q,2Qの売上高はQoQ微増も、マチュアロジック、メモリの稼働調整色が強まり、減収
✓ ハードディスク向け	△53.1%	: HDDからSSDへの移行が進む中、HDDの生産及び在庫の調整も継続し、減収
✓ 一般工業用向け	△4.1%	: 産業機械向け需要の減少や半導体製造装置の設備投資が調整局面にある影響を受け、減収
✓ 株主還元		: 1株当たり配当額は期初予想36.67円を維持

【2024年3月期 下期業績予想】 **同年上期比

✓ 売上高	**△4.8%	: 下期においても半導体市場の調整は継続し、本格的な回復には時間を要すると想定
✓ 営業利益	△20.2%	:
✓ 経常利益	△27.3%	:
✓ 当期純利益	△28.3%	:

技術を磨き、心をつなぐ

FUJIMI

FUJIMI INCORPORATED